

客户 CUSTOMER: _____

日期 DATE: _____

纳入仕様书 SPECIFICATION

Preliminary

产品名称 PRODUCT NAME: 叠层片式双工器

Multilayer Chip Diplexer

贵司料号 YOUR PART NO.:

敝司料号 OUR PART NO.: MDPX18M0917P69-D05

版本号 VERSION.: V1.2

接受 RECEPTION

THE SPECIFICATION HAS BEEN ACCEPTED.

该纳入仕様书已被我司接受

日期:
DATE:

公司:
COMPANY:

批准
CFMD

审核
CHKD

接收
RCVD

本纳入仕様书共 6 页

MANUFACTURING NAME

深圳市麦捷微电子科技有限公司

SHENZHEN MICROGATE TECHNOLOGY CO., LTD

TEL: 86-755-28085000

FAX: 86-755-28085605

CFMD. 批准	CHKD. 审核	DSGD. 担当
梁启新	付迎华	曾艳峰

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

地址: 深圳市坪山新区坪山大道 6075 号龙田科技园二巷 6 号

电话(Tel): 0755-28085000

传真(Fax): 0755-28085605

邮编(Postcode): 518118

纳入仕様书改定履历 MODIFY HISTORY OF SPECIFICATION

Ver.	DATE	CONTENT	APPROVED
1.0	2020.05.24	初稿 Constitute	梁启新
1.1	2020.08.11	更新产品外形 Modify the Product Appearance	梁启新
1.2	2020.08.17	更新产品功率容量 Modify Power Capacity	付迎华

目录 CATALOG

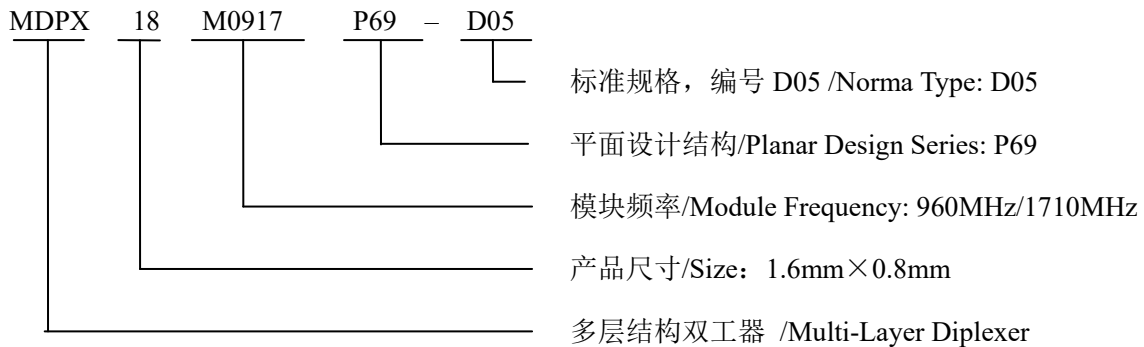
1 适用范围 Scope.....	4
2 品名构成 Product Identification.....	4
3 形状、尺寸和材料 Appearance, Dimensions and Material.....	4
4 测试条件 Testing Conditions.....	4
5 电气性能 Electrical Characteristics.....	5
6 焊接条件 Recommended Soldering Conditions.....	6

1 适用范围 Scope

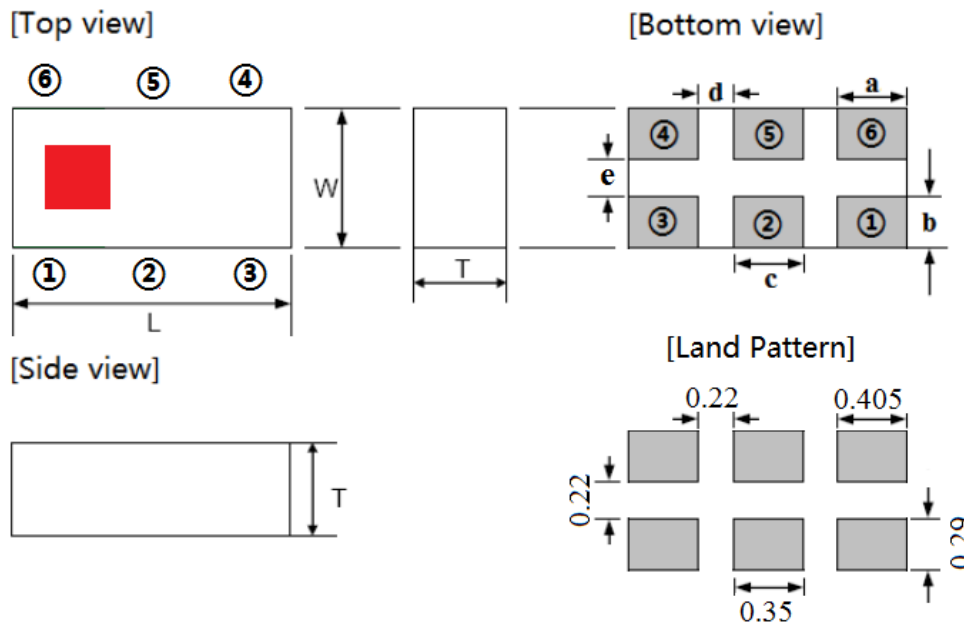
“麦捷”叠层片式双工器系列产品设计用于 5G、LTE、WIFI、Bluetooth、PDA 和无绳电话机等，具有低的插入损耗、高的隔离度和小体积 SMD 片式设计，能减少复杂的调校工作，可以简化电路设计。

“Microgate” Multilayer Chip Diplexer series are designed to be used in 5G、LTE、WIFI、Bluetooth、PDA & cordless phones with low insertion loss and high isolation as well as small size SMD chip design , which can simplify your complex tuning and circuit design .

2 品名构成 Product Identification



3 形状、尺寸和材料 Appearance, Dimensions and Material



PIN Configuration

①	②	③	④	⑤	⑥
GND	Common Port	GND	High Band Port	GND	Low Band Port

Dimension:

Unit:mm

L	W	T	a	b	c	d	e
1.6±0.15	0.8±0.15	0.7±0.1	0.405±0.1	0.29±0.1	0.35±0.1	0.22±0.1	0.22±0.1

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

地址: 深圳市坪山新区坪山大道 6075 号龙田科技园二巷 6 号

电话(Tel): 0755-28085000

传真(Fax): 0755-28085605

邮编(Postcode): 518118

4

4 测试条件 Testing Conditions

除非另有规定，否则在以下条件下测试 <Unless otherwise specified>

温度 Temperature : Ordinary Temperature (-40 to +85°C)

湿度 Humidity : Ordinary Humidity (25 to 85% RH)

大气压强 Atmospheric Pressure : 86 to 106 kPa

5 电气性能 Electrical Characteristics

操作温度范围 Operating Temperature Range : -40 to +85°C

保存温度范围 Storage Temperature Range : -40 to +85°C

No.	Item (项目)	Frequency (MHz)	Specifications (特性)
5.1	Insertion Loss (in f1) 插入衰耗	699~960	0.55dB Max @25°C
			0.6dB Max @-40°C~85°C
5.2	Insertion Loss (in f2) 插入衰耗	1710~2690	0.5dB Max @ 25°C
			0.6dB Max @-40°C~85°C
5.3	VSWR (in BW) 回波损耗 (in f1 & f2)	699~960	1.5 Max
		1710~2690	
5.4	Attenuation 阻带衰耗 (in f1)	1406~1496	3.5dB min.
		1554~1574	12dB min.
		1648~1724	20dB min.
		1760~1830	25dB min.
		2109~2361	25dB min.
		2472~2586	29dB min.
		2640~2745	27dB min.
		3400~3600	21dB min.
5.5	Attenuation 阻带衰耗 (in f2)	699~915	20dB min.
		4905~5150	20dB min.
		5150~6500	25dB min.
	Isolation 隔离度	699~960	20dB min.
		1710~2690	25dB min.
5.6	In/Output Impedance 输入/输出阻抗		50 Ω
5.7	Max Power		4W

6 焊接条件 Recommended Soldering Conditions

1、焊剂 Flux, Solder

① 使用松香助焊剂，禁止使用卤化物含量超过 0.2wt% 的强酸性助焊剂。

Use rosin-based flux. Don't use highly acidic flux with halide content exceeding 0.2wt% (chlorine conversion value).

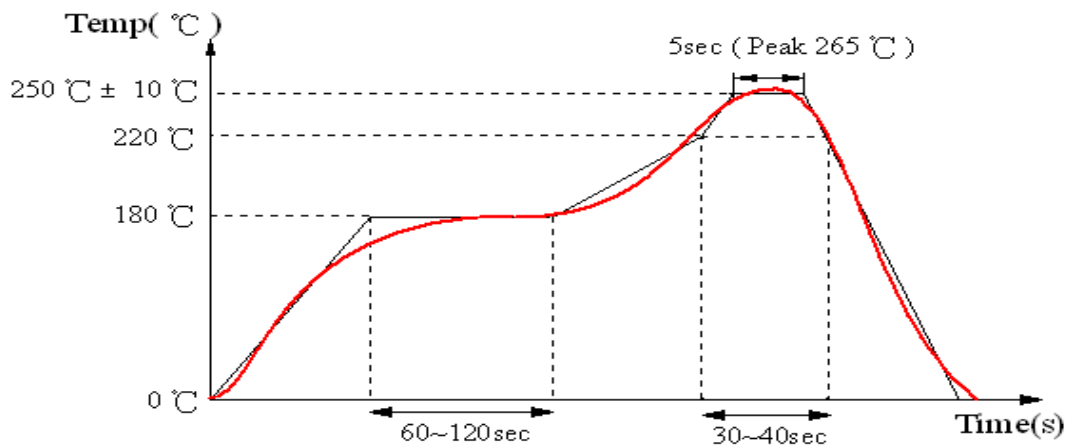
② 使用纯锡焊料 Use Sn solder.

2、回流焊条件 Reflow soldering conditions

● 预热时，产品表温与焊料温度的温差最大不允许超出 150°C，焊接完后冷却时，产品表温与溶剂温度之间的温差最大不允许超出 100°C。预热不足有可能引发产品表面裂纹，导致产品品质下降。

Pre-heating should be in such a way that the temperature difference between solder and product surface is limited to 150°C max. Cooling into solvent after soldering also should be in such a way that temperature difference is limited to 100°C max. Unwrought pre-heating may cause cracks on the product, resulting in the deterioration of products quality.

● 标准回流焊曲线 Standard soldering profile.



3、手工返工 Reworking with soldering iron

当使用电烙铁进行手工焊接时，以下条件必须严格遵守 The following conditions must be strictly followed when using a soldering iron.

预热 Pre-heating	150°C, 1 minute
尖端温度 Tip temperature	280°C max
输出功率 Soldering iron output	30w max
电烙铁头尖端尺寸 End of soldering iron	φ3mm max
焊接时间 Soldering time	3 seconds max